

Pájecí pasta ALPHA®

Nejvyšší výkon
a výtěžnost a nejnižší
pořizovací náklady pro
současné náročné
procesy montáže
elektronických
zařízení.

Pájecí pasty ALPHA® se používají pro montáž desek plošných spojů u různých výrobních aplikací a zahrnují: ruční elektronická zařízení, počítačové základní desky, spotřební elektroniku, síťové servery, automobilová zařízení, zařízení pro aplikace ve zdravotnictví a armádě a mnoho dalších.

BEZOPLACHOVÉ VÝROBKY (NO-CLEAN)

ALPHA® CVP-360 (bez halogenů)

- Umožňuje vysokou výtěžnost a výkon s použitím nízkonákladových slitin SACX
- Vynikající roztékání a smáčení na OSP a jiných povrchových úpravách desek
- Nejlepší ve své třídě pro minimalizaci falešné negativy při testech ICT

ALPHA® CVP-390 (ZHP)

- Vynikající procesní okno při pájení reflow umožňující prohřev při 175-180 °C po dobu 60 sekund
- Slití při velikosti vrstvy pájecí pasty 180 µm
- Méně „Head in Pillow“ (HiP) defektů
- Překračuje požadavky normy IPC 7095, třída III Voidy (bublíny) pro profil prohřevu a malou tvorbu bublin u velkoplošných depozit
- Kompatibilní se slitinami SAC305 a SACX Plus®. Slitiny s nízkým obsahem stříbra mají lepší výsledky testu pádovým rázem v porovnání se slitinami s vysokým obsahem stříbra

ALPHA® CVP-520 (ZHP)

- Bezolovnatá slitina s nízkým bodem tání
- Vynikající výsledky technologie THT
- Umožňuje pájení přetavením u citlivých součástek s průchozím otvorem
- Možnost eliminace pájení vlnou u aplikací se smíšenou technologií

ALPHA® OM-340 (ZHP)

- Bezoplachová pasta bez olova s širokým pracovním rozsahem
- Vynikající možnost testování ICT
- Lepší roztékání a smáčení
- Vynikající odolnost proti HiP defektům

ALPHA® OM-338T (ZHP)

- Široký pracovní rozsah, bezoplachová; vhodná pro většinu bezolovnatých aplikací technologie SMT
- Široký teplotní rozsah přetavení a vynikající odolnost proti tvoření bublin
- Schopnost tisku s malou roztečí (fine pitch) s rychlostí tisku až 200 mm/s (8 in/s)

ALPHA® OM-338 PT (ZHP)

- Vynikající možnost testování vývodů ICT
- Vynikající výsledky v tiskových zařízeních s uzavřenou hlavou
- Široký rozsah zpracování tisku až 150 mm/s (6 in/s)

ALPHA® OM-338 CSP (ZHP)

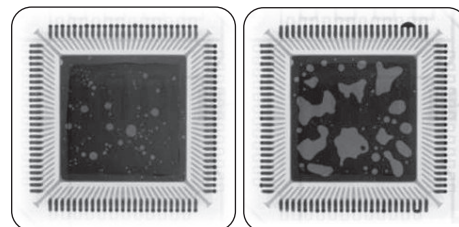
- Bezoplachová pasta bez olova s širokým pracovním rozsahem
- Technologie umožňující rozteč BGA 0,4 mm
- Vynikající možnost tisku pro různá provedení desek

ALPHA® OM-5100 (ZHP)

- Široký pracovní rozsah, bezoplachová; vhodná pro většinu Sn/Pb aplikací technologie SMT
- Vyšší výtěžnost přetavení s vynikající konzistencí nanesené pasty při tisku
- Nižší výskyt nepravidelných a mid-chip kuliček pájky

ZHP: ZERO Halogen Product = bez záměrně přidaného halogenu

Bezoplachová pájecí pasta CVP-390

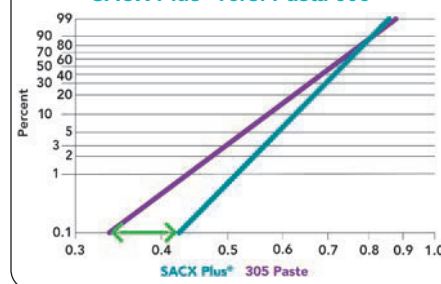


Nízké tvoření bublin s použitím pájecí pasty CVP-390

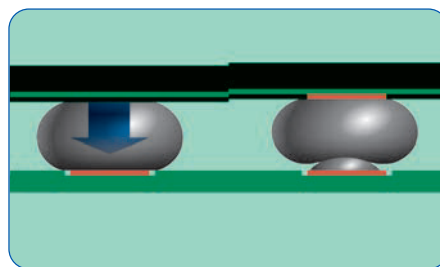
Vysoké tvoření bublin s pájecí pastou konkurence

Údaje ze zkoušky pádovým rázem (drop-shock) pro pastu s nízkým obsahem Ag

Výsledky závod při testu pádovým rázem SACX Plus® vers. Pasta 305



Bezoplachové pájecí pasty ALPHA CVP390 a ALPHA OM340



ALPHA CVP390 a ALPHA OM340 (vlevo) snižují výskyt defektů head in pillow v porovnání s konkurenčními pájecími pastami vpravo.



Bez halogenů, dle směrnic uvedených v následujících průmyslových normách: IPC-4101B, IEC-61249-2-21 a JPCA-ES-01-1999.

- Výrobky předních technologií
- Celosvětově trvalé výrobní výsledky
- Kontinuita dodávek je zajištěna díky více výrobním zařízením

UKAZATELE VÝSLEDKŮ	NÁZEV PRODUKTU	Bezoplachová	Ve vodě oplachová	Bezolovnaté SLITINY							SnPb SLITINY			Velikost prášku			Podíl kovu (hmotnostních %)	Označení viskozity (Malcolm při 10 RPM)	Klasifikace tavidla dle J-STD 004	Verze pro dispenser: Podíl kovu a viskozita	Obsah halogenů			
				SACX 0307	SACX 0807	SACX plus 0807	InnoLot	SAC 305	SAC 387	SAC 405	Sn/Bi/Ag	Sn63/Pb37	Sn62/Pb36/Ag2	Sn62,8/Pb36,8/Ag0,4	Typ 3	Typ 4						Typ 4.5		
BEZOLOVNATÁ	Univerzální, nejvyšší rychlost tisku	ALPHA® OM-338 T	•																	88,3 % M04	ND			
	Univerzální, testovatelnost vývodů, uzavřené tiskové hlavy	ALPHA® OM-338 PT	•																	88,5 %	M15	ROL0	NA	ND
	Umožňuje montáž BGA 0,4 mm	ALPHA® OM-338 CSP	•																	88,3 %	M11	ROL0	83,5 % M04	ND
	Vysoký prohřev profilu, pasta v průchozím otvoru	ALPHA® CVP-390	•	•																88,6 - 89,2 %	M17 M20	ROL0	TBD	ND
	Vyšší roztékání a smáčení	ALPHA® OM-340	•	•																88,5 %	M18	ROL0	NA	ND
	Univerzální, ve vodě rozpustná	ALPHA® WS-820		•																87,6 %	M19	ORH0	85 % M9	NA
	Vysoce hodnotná slitina SACX, testovatelnost pinů	ALPHA® CVP-360	•		•															88,5 %	M15	ROM0	83,3 % M04	<900 ppm
	Vynikající výsledky pasty v průchozím otvoru, slitina s nízkým bodem tání	ALPHA® CVP-520	•																	90 %	M21	ROL0	85,3 % M04	ND
CÍN-OLOVO	Univerzální, široké procesní okno	ALPHA® OM-5100	•																	90,0 %	M13	ROL0	85 % M04	ND
	Životnost na šabloně, vzhled spojů, čistitelnost	ALPHA® WS-809		•																90,0 %	M18	ORH0	NA	NA

NA: neaplikovatelné
ND: nezjištěno

OPLACHOVÉ PRODUKTY

ALPHA® WS-809

- Oplachová pájecí pasta Sn/Pb vhodná pro většinu SMT aplikací
- Vynikající životnost na šabloně a čistitelnost
- Poskytuje výbornou průchodnost a výtěžnost
- Zajišťuje vynikající výkon a vysoký výnos procesu

ALPHA® WS-820

- Zajišťuje vynikající objem a konzistenci tisku
- Vysoká výtěžnost při přetavení s výsledky tvorby bublin dle normy IPC, třída III
- Vynikající čistitelnost po přetavení

Pro kompletní podporu požadavků SMT tisku nabízí společnost ALPHA také kompletní řadu šablon a čističů ALPHA®.

